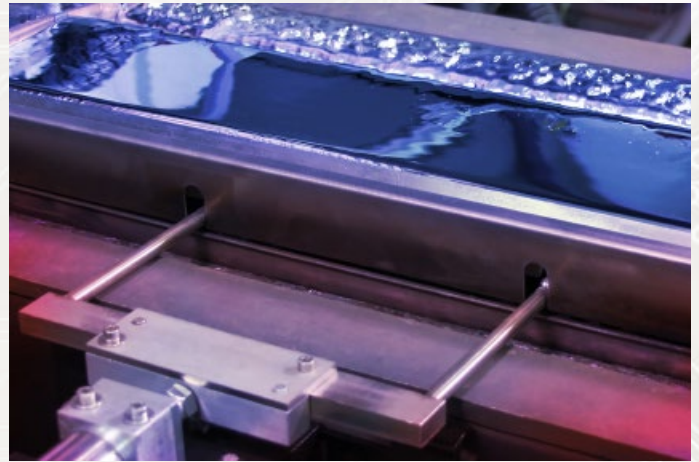


锡波后导流自动调节

锡波后导流自动调节主波流动，
配合基板传动速度以减少缺陷。

自动化、减少缺陷、可重复性、MES 信息管理和简化操作，这些始终是电路板组装制造业各个方面的市场驱动力。Electrovert 的锡波后导流自动调节功能自动调节主波流动，以匹配电路板速度，减少缺陷。由制程控制的设定点确保后导流自动调节焊锡波流，保证每一类型 PCB 和应用都能获得最佳的波形动态。

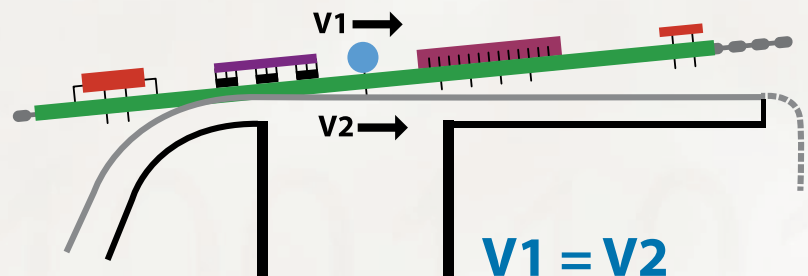


基板传动速度与焊锡流速匹配, 更高良率

为了充分优化主波的流速动态，PCB 的传动速度需要与后导流板内焊锡的流速相同 ($V1=V2$)。PCB 从焊锡上“剥离”时，当 $V1=V2$ 时，波流动态得到完全优化，从而最大限度避免桥接缺陷(和产品设计及制程相关)。后导流特有的自动调节功能对于优化波形流速动态来说通常是必须的。

锡波后导流自动调节的价值和好处:

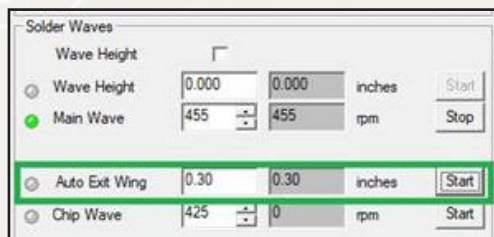
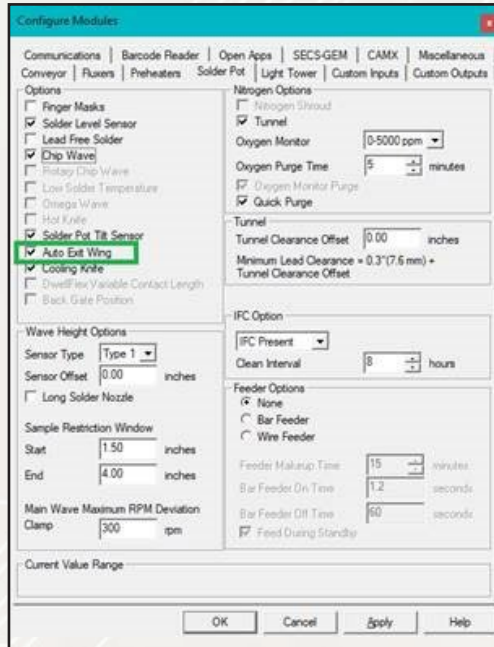
- 增加主波流动的可重复性，同时在产品转换期间无需技工调节
- 减少与不适当的主波流动相关的缺陷
- 能获取设备软件内的由制程控制的设定点数据,用于 MES 信息管理应用
- 后导流自动调节能精确控制导流板，具备高度重复性
- 兼容所有 Electrovert 的 UltraFill 4.0 和 DwellMax 4.0 喷嘴系统(空气, 氮气护罩和氮气隧道系统)



基板速度 = 焊锡流速

锡波后导流自动调节

Electrovert 的后导流自动调节解决方案给重视可高度重复制程的制造商提供了许多好处。该系统减少了在产品转换期间对熟练技工的需求，减少了桥接缺陷，改善了顶部通孔填充，从而达到最佳焊接性能。锡波后导流自动调节支持工业4.0级自动化，同时能为 MES 信息管理应用获取数据。



锡波后导流自动调节规格

制程类型	兼容有铅和无铅应用
型号	VectraES (VES3 和 VES2) VectraElite (VC3 和 VC2) Electra (EC4 和 EC3)
喷嘴类型	UltraFill 4.0 (空气, 氮气护罩和氮气隧道) DwellMax 4.0 (氮气隧道)
制程宽度	0.6" (15 mm)
材质类型	VectraES (melonite 涂层和钛) VectraElite (钛) Electra (钛)
集成软件的特性	<ul style="list-style-type: none"> • 制程控制 • 兼容智能参数载入 (允许单件批量生产) • 兼容三步待机模式和机器软件内的 FloLift • 兼容 ExactaWave 自动波高控制 • 兼容 MES 协议
现场可升级	咨询工厂



ITW EAE 是依工集团旗下 (Illinois Tool Works, Inc) 的一个分支集团。它合并了所有电子组装设备和热处理技术。集团产品包括 MPM, Camalot, Electrovert, Vitronics Soltec 和 Despatch 的世界级产品。

© 2023 ITW 版权所有。 Auto Exit Wing CN 12-2021

www.itweae.com

Electrovert

Cleaning & Soldering Solutions

ITW EAE